

SMD

额定电感 0.82 μH 至 1000 μH
额定电流 0.34 A 至 7.6 A



施工

- 铁氧体磁芯
- 防磁
- 缠绕：漆包铜线
- 绕组焊接到终端

特点

- 温度范围可达150°C
- 高额定电流
- 低直流电阻
- 适用于无铅回流焊
如引用在JEDEC J -STD 020C
- 符合AEC -Q200标准
- 符合RoHS标准

应用

- 电源电压滤波
- 耦合，去耦
- DC / DC转换器
- 汽车电子
- 工业电子产品

码头

- 基材CuFe2P
- 层组合物中的Ag，锡（无铅）
- 电镀

记号

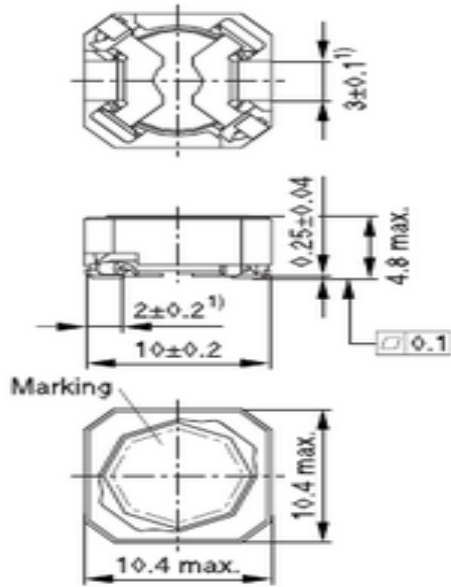
- 基于组件的标记：
制造商，L值（NH，编码），
L公差（编码），生产日期（YWWDD）
工单的最后两个数字
- 盘上最小的数据：
制造商，订购代码，
L值，数量，包装日期

分选方式及包装设备

- 16毫米的泡裹带，缠绕在330毫米 \varnothing REEL
- 包装单位：750个/卷。

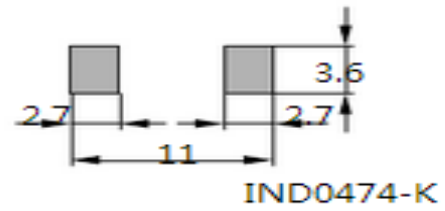
SMD

尺寸图和布局的建议



1) Soldering area

IND0477-H-E



尺寸 (mm)

SMD
技术参数和测量条件

额定电感L	R	测量阻抗分析仪Agilent 4294A在 频率f, 0.1 V, 20°C
额定温度T	R	85 °C
额定电流I	R	马克斯。允许直流随温度的升高 在额定温度 ≤ 40 K
饱和电流I	SAT	马克斯。允许DC与电感下降 $\frac{\Delta L}{L_0}$ 约. 10 %
直流电阻R	最大	测得在20°C下
焊 (无铅)		浸和外观的方法Sn95.5Ag3.8Cu0.7 : (245 \pm 5)°C, (5 \pm 0.3) s 润湿焊接区 $\geq 90\%$ (根据IEC 60068-2-58)
焊锡耐热性		260 ° C, 40秒 (以引用的JEDEC J -STD 020C)
气候类别		55/150/56 (符合IEC 60068-1)
储存条件 :		安装 : -55 °C ~ +150°C 包装 : -25 °C ... + 40 ° C, $\leq 75\%$ RH下
重量		约. 2克